

# **2024 IC Taiwan Grand Challenge**

## **競賽試行辦法**

**主辦單位：國家科學及技術委員會**

**共同主辦：國際半導體產業協會、台灣半導體產業協會、台北市電腦商業同業公會**

# 目錄

一、 關於 IC Taiwan Grand Challenge .....	1
二、 競賽領域 .....	1
三、 報名資格 .....	2
四、 競賽流程 .....	3
五、 評審組成與評分項目 .....	3
六、 獎勵內容 .....	4
七、 獲獎義務 .....	4
八、 其他注意事項 .....	5
九、 聯絡方式 .....	6

# IC Taiwan Grand Challenge

## 競賽試行辦法

### 一、 關於 IC Taiwan Grand Challenge

由台灣政府跨部會合力推動之晶創臺灣方案(Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program，簡稱 Taiwan CbI)，為善用台灣半導體高科技產業鏈優勢，以晶片結合生成式 AI 等關鍵技術，並以「結合生成式 AI+晶片帶動全產業創新」、「強化國內培育環境吸納全球研發人才」、「加速異質整合及先進技術」、「利用矽島實力吸引國際新創與投資來臺」等四大布局，帶動全產業發展。

其中，為強化台灣全球最大 IC 新創聚落品牌，吸引全球尖端科技人才及創投資金來台，國家科學及技術委員會舉辦 IC Taiwan Grand Challenge，提供在地誘因包括彙整關鍵資源(如晶片下線、光罩、IP 服務)、攜手指標半導體企業投資媒合及成立公私合資專屬投資基金，藉此吸引全球潛力晶片應用技術方案新創、學研機構、人才參與徵選，打造台灣成為夢想現實之地。

為即早發掘潛力團隊、建立與台灣之鏈結，IC Taiwan Grand Challenge 於 2024 年首度舉辦，將鎖定 IC 設計創新(IC design innovations)與晶片創新應用(Chip-based innovative applications)的全球新創及學研團隊，透過競賽擇優篩選來台設立據點、鏈結國際與民間資金擴散晶片新創應用，以全球最完整的半導體產業生態、快速支援創意實踐。

台灣政府也期盼藉此獎項，整合在地 IC 設計、製造、封裝測試到產品流程，以跨國際、跨產學研的徵獎規模，將全球具創新潛力的未來之星匯聚在台，讓人才有發揮空間並實質落地、帶動商機同時驅動相關產業發展。

### 二、 競賽領域

針對以下領域發展之精進技術或應用解決方案：

**第一類：IC 設計創新(IC design innovations)：**具 IC 設計自有技術及核心 IP，規劃發展創新晶片之學研或新創團隊。

**第二類：晶片創新應用(Chip-based innovative applications)：**具百工百

業領域知識(domain knowledge)，規劃結合現有晶片技術實現運用之學研或新創團隊，例如以下主題：

■Smart Data & Security (資安、量子計算、數位經濟)

■Smart Mobility(電動車、自動駕駛、智慧城市)

■Smart Manufacturing(智慧製造、IC 製程、機器人)

■Smart Medtech(生物辨識、智慧監測)

■Sustainability(永續製造、節能創新)

### 三、 報名資格

(一) 規劃攜手台灣半導體晶片設計、製造產業，共同合作發展創新應用之新創、法人及學研機構、自然人，並符合下列資格均可提出：

1. 須為 2016 年 1 月 1 日之後成立的新創
2. 不得為大陸地區之新創、法人及學研機構、自然人或大陸地區人民、法人團體或其他機構由第三地來臺投資設立之新創
3. 資金來源不得有「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第 3 條第三地公司之資金。(第三地公司指大陸地區人民或法人或機構直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾百分之三十；或對該第三地區公司具有控制能力者)

(二) 參賽單位須擁有該產品、技術或解決方案之智慧財產權或已取得合法授權使用。

(三) 參賽單位須於指定時間內提供構想書(初審)及進行簡報(複審)，構想書內容包括技術核心、目前已解決或獲得驗證情形、欲發展之商業模式、市場拓展規劃等。

#### 四、 競賽流程

本獎項徵選分為線上競賽及實體競賽 2 種報名團隊皆可參與不限次數，說明如下：

##### (一) 線上競賽：

1. 共兩梯次受理報名，第一梯至 2024/6/30 截止、第二梯 2024/9/4-2025/1/31 截止，截止後兩週彈性開放團隊補齊申請資料。
2. 線上報名：有意參賽者可隨時線上填寫報名表格並上傳所需提交之資料，包含 IC 新創加速平台資源需求申請表(請參考附件一)  
線上報名網址：[ictaiwanchallenge.org](http://ictaiwanchallenge.org)
3. 資格審查：由主辦單位依據辦法進行資格審查及確認競賽類別。
4. 初審：構想書內容審查，依審查結果後另行通知是否進入複審。
5. 複審：以線上進行報告與問題詢答，簡報者需具備流利英文聽說能力，全程以英文呈現(含簡報及答詢)，時間共計 20 分鐘。
6. 結果公告：將視送件案件量由主辦單位安排審查時間，並於當次複審結束後兩週通知團隊結果。

(二) 實體競賽：參加主辦單位指定的國際指標展會(例如：Viva Technology 2024、CES 2025)合作之競賽，於展期進行 Pitch 後公告結果。團隊參賽申請時，需提交 IC 新創加速平台資源需求申請表(請參考附件一)。

#### 五、 評審組成與評分項目

合作競賽場次將陸續公布，各競賽進行方式依該場次規定辦理。

(一)評審組成：邀請台灣產業、創投、政府部門等領域專家組成委員會，經由初審、複審階段選出獲獎團隊。

(二)評分項目：

評選標準	說明	評分 佔比
在地連結性	1. 具有來台資源需求及具體發展規劃 2. 能為台灣產業提供更寬廣的發展空間	40%
技術創新性	1. 於新興應用領域之創新性 2. 在製程、設計、新材料運用範疇具開創性 3. 能融入多元創新與整合跨域思維優勢	20%
價值創造性	1. 能帶動科技創新潛力，創造社會福祉 2. 促成新產業鏈結或促進產業升級之貢獻 3. 引進衍生投資或創造高度經濟價值之成效	40%

## 六、 獎勵內容：

- (一) 台灣商務落地鏈結：赴台來回機票及住宿補費用，其補助限用於參加 2024 或 2025 台灣創新技術博覽會(TIE)未來科技展，包含展示、頒獎及商務媒合形成，並享有展會虛實整合展出及系列宣傳資源。
- (二) IC 新創加速平台產業鏈結及在台晶片發展輔導：協助對接在台期間所需免費 EDA 工具一年使用、矽智財授權服務(提供免費基礎 IP 及其他特殊功能 IP 部分資助)、IC 專業設計服務部分資助、光罩晶圓共乘 Free Shuttle 資助，其他需求彈性額度(如特殊 EDA、特殊下線製程、封裝測試等，及在台商務開發)資助，將依實際需求提供所需的投資資助。
- (三) 產業專家業師輔導：邀集合作半導體產業企業、資深技術專家、創投等組成業師團對獲選新創提供專業輔導諮詢。
- (四) 其他落地資源：給予獲選新創台灣國際新創基地 TTA 進駐空間(台北小巨蛋及南部據點，<https://www.taiwanarena.tech/>)及相關商務開發輔導。專職輔導經理擔任新創與顧問/業師間輔導橋樑，協助新創串接所需資源。

## 七、 獲獎義務

- (一) 團隊參賽申請時需提交附件一申請表單，將依團隊選擇方案提供資

源協助，並據以轉換為股權，由行政院國家科學技術發展基金佔股7%-10%。

- (二) 獲獎團隊須於公告後三個月內完成投資協議書合約簽訂，並提交「持股證明書」，逾期未交付者須返還所使用輔導資源等值現金。主辦單位保有權利允以延展。合約簽約對象須為公司，若獲選對象為新創或學研團隊，須於簽約前成立公司才可獲得補助。
- (三) 獲獎者須來台進行實體鏈結發展，例如於2024年8月31日前通過者，需於2024台灣創新技術博覽會(TIE)實體展示；8月31日後通過者，將於2025台灣創新技術博覽會(TIE)實體展示。
- (四) 獲獎者需協助廣宣活動提交相關資料或參與宣傳，並配合主辦單位安排之在台對接行程活動及管考審查等事項。

## 八、其他注意事項

- (一) 參賽標的內容嚴禁抄襲、翻譯、改寫、侵害智慧財產權等違法侵權之情形。主辦單位若發現參賽作品有違反上述事項，得撤銷其參賽資格或得獎之權利，如若造成主辦單位或其他任何第三者之權益損失，違反者應自負法律責任。
- (二) 參賽團隊須保證所有填寫或提出之資料均屬事實且正確，且不可冒用任何第三人之資料，如有不實或不正確之事，主辦單位有權取消其參賽資格。
- (三) 參賽團隊應尊重評審委員會決定，除能具體證明其他參賽團隊違反本辦法相關規定，對評審結果不得有其他異議。
- (四) 主辦單位基於參賽者管理、報名管理、活動期間身分確認、活動聯繫、競賽活動相關訊息聯繫及相關行政作業之目的，得蒐集處理參賽者或其他成員之個人資料。不同意蒐集處理其個人資料者，主辦單位得取消該參賽者入圍或得獎資格。
- (五) 根據中華民國所得稅法，本競賽之得獎人獎金須依稅法相關規定預

扣繳所得稅。得獎者應提供其身分證明相關文件，供主辦單位報稅使用。

- (六) 出於非營利宣傳目的，主辦方有權使用參賽者提供的產品技術訊息，進行出版、著作、公開展示、及發行各類型態媒體宣傳之權利。
- (七) 凡報名參加此競賽者，即視為已充分瞭解此規則中各條款，且願意完全遵守本規則所述之各項規定。
- (八) 主辦單位保留修改本試行辦法之權利，將滾動修正並即時公布，如有未盡事宜，悉依本會相關規定或解釋辦理。

## 九、 聯絡方式

競賽聯絡窗口：台北市電腦商業同業公會 Annett Wu

聯絡電話: +886 2 25774249 Ext. 312

Email：annett@mail.tca.org.tw

IC 新創加速平台聯絡窗口：國科會曾子倩專員

聯絡電話：+886 2 27377136

Email：tctseng2@nstc.gov.tw



## 附件一：IC 新創加速平台資源需求申請表

IC 新創加速平台資源需求申請表			
<p>辦法說明：</p> <p>1. IC 新創加速平台藉助臺灣在半導體領先的實力與豐沛的資源，彙整晶片開發所需之關鍵資源，協助全球 IC 新創加速實現潛力產品。</p> <p>2. IC 新創加速平台提供之服務概分下列數類，新創企業可依自身需求選擇合適方案，<u>請務必勾選方案及簽名同意</u>。</p> <p>3. 各方案中所提供之補助資金皆須在臺運用。</p> <p>4. 各方案中所提供之補助資源與金額將轉換為股權，由行政院國家科學技術發展基金佔股，佔股比重亦詳列於方案表中。</p>			
方案	內容	佔股比例	價值
<input type="checkbox"/> 一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 光罩晶圓共乘一次 free shuttle 機會</li> <li>■ 晶片其他需求彈性額度(如特殊 EDA、特殊下線製程、封裝測試等，及在台商務開發) USD 200K</li> </ul>	7%	USD 500k 以上
<input type="checkbox"/> 二	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 提供免費基礎 IP</li> <li>■ 提供共用補助金 USD 1.3M：可使用在矽智財授權、IC 專業設計服務、光罩晶圓共乘三部分。</li> <li>■ 晶片其他需求彈性額度(如特殊 EDA、特殊下線製程、封裝測試等，及在台商務開發) USD 200K</li> </ul>	9%	USD 2M 以上
<input type="checkbox"/> 三	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 免費 EDA 工具一年使用</li> <li>■ 提供免費基礎 IP</li> <li>■ 提供共用補助金 USD 1.3M：可使用在矽</li> </ul>	10%	USD 3M 以上

	<p>智財授權、IC 專業設計服務、光罩晶圓 共乘三部分。</p> <p>■ 晶片其他需求彈性額度(如特殊 EDA、特殊下線製程、封裝測試等，及在台商務開發) USD 200K</p>		
<p>詳細需求說明：(請詳細說明產品與需求細節，包括產品規格、製程節點、台灣廠商合作內容等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品名稱與功能方塊圖(Block diagram)：</li>   <li>● 產品規格：(請條列細節)</li>   <li>● 製程節點：_____ nm</li>   <li>● 封測特殊需求：</li>   <li>● 系統整合需求：</li>   <li>● 產品開發之時程規劃：</li>   <li>● 已接洽過之臺灣廠商：</li>   <li>● 其他需求說明：(請條列，如產品開發需求之額外補充、注意事項、生活庶務或商務開發需求...等)</li> </ul>			
<p>簽名同意(公司以負責人或 CEO 簽署；團隊則需所有團隊成員簽署)：</p> <p>_____</p>			